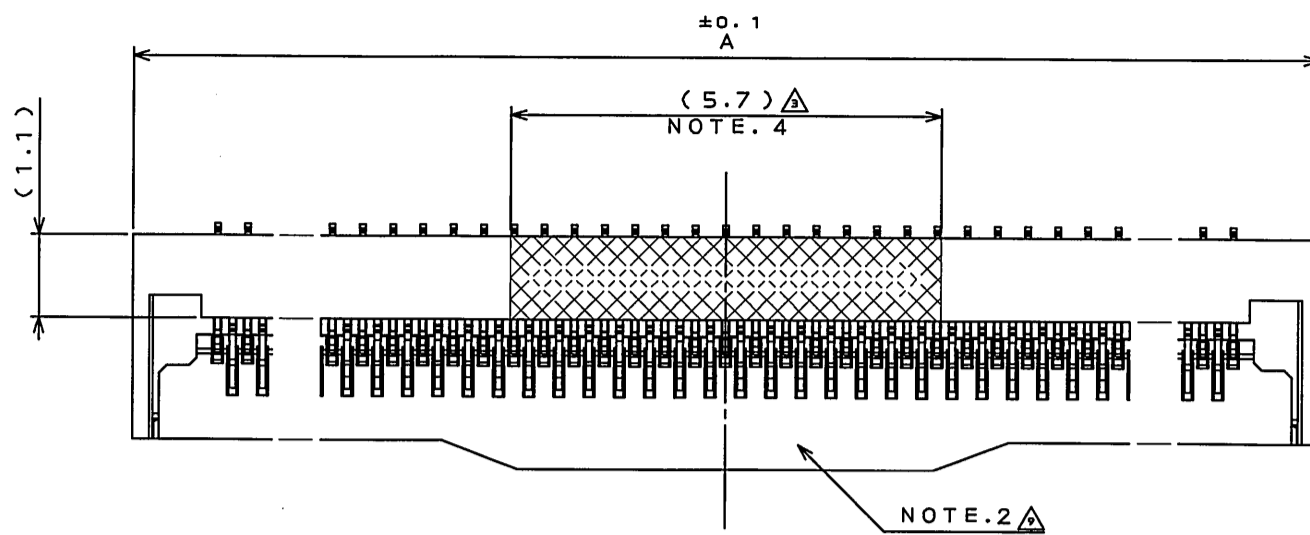
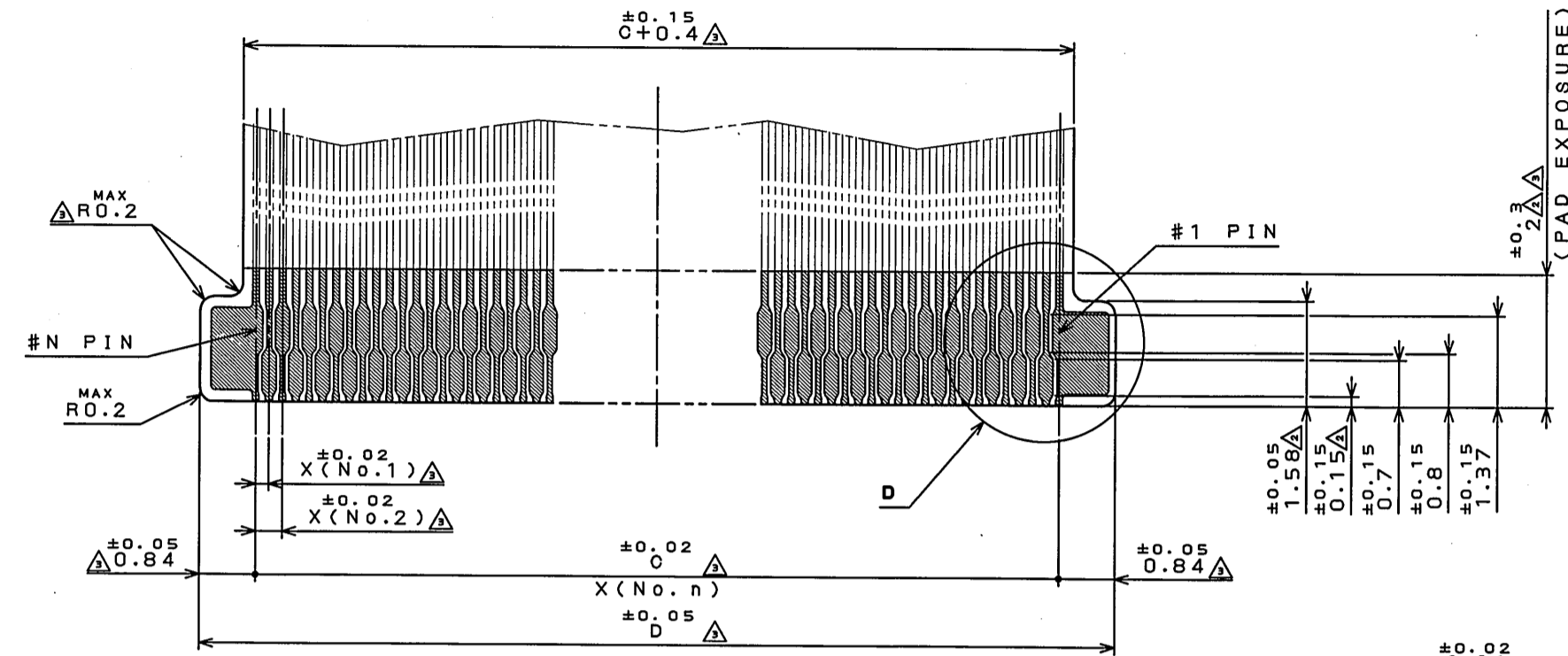
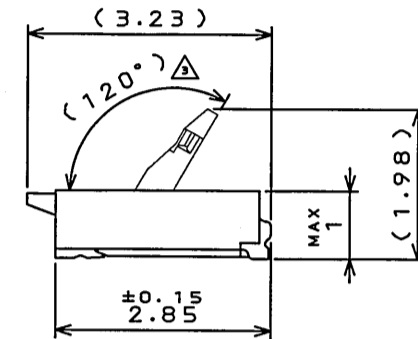
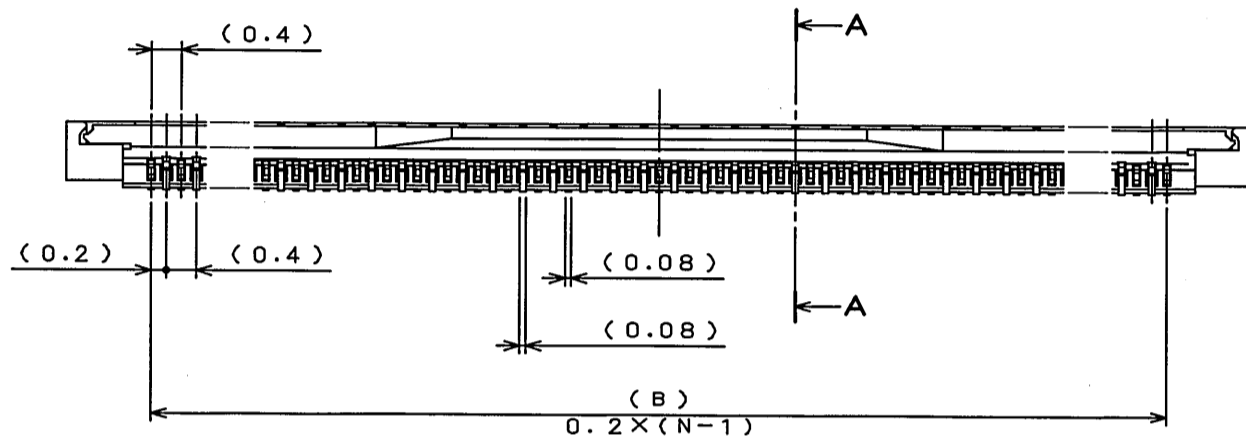


REV.	DATE	CON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
8	25.May.2010	069988	Added New Items		K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI
9	9.Sep.2010	070484	Changed Marking Position Of Lot Number		K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI
10	27.Oct.2010	070937	Changed Applicable F.P.C. Dimension(REF.)		K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI

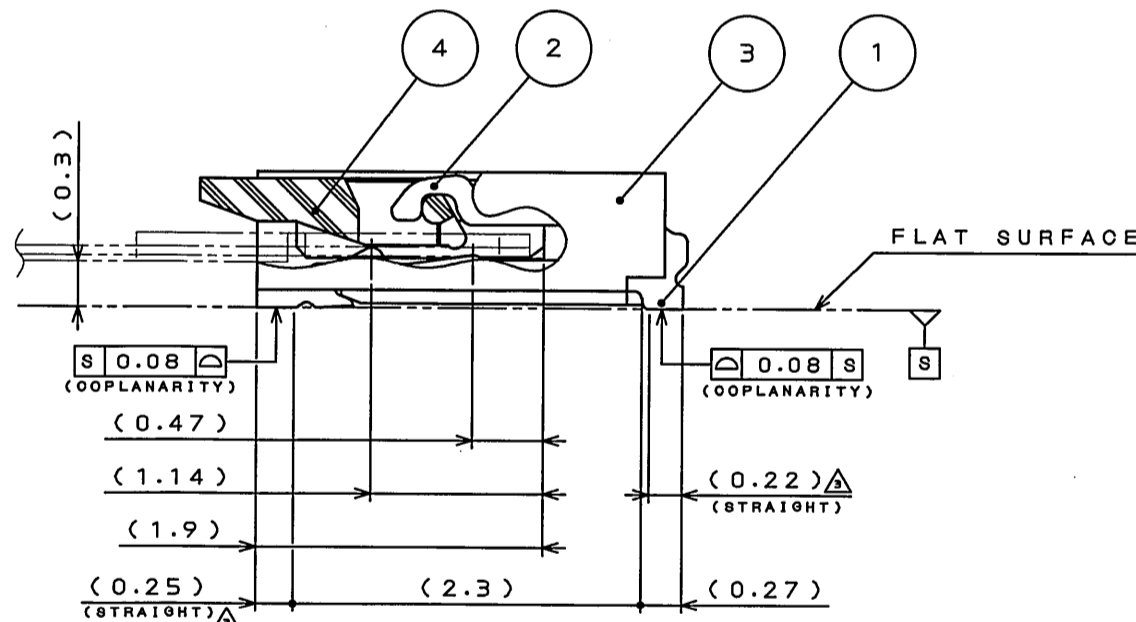
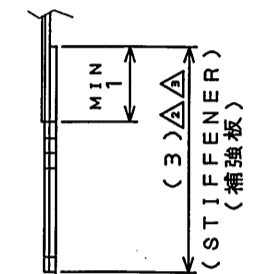


△ TABLE 3. DIMENSIONS

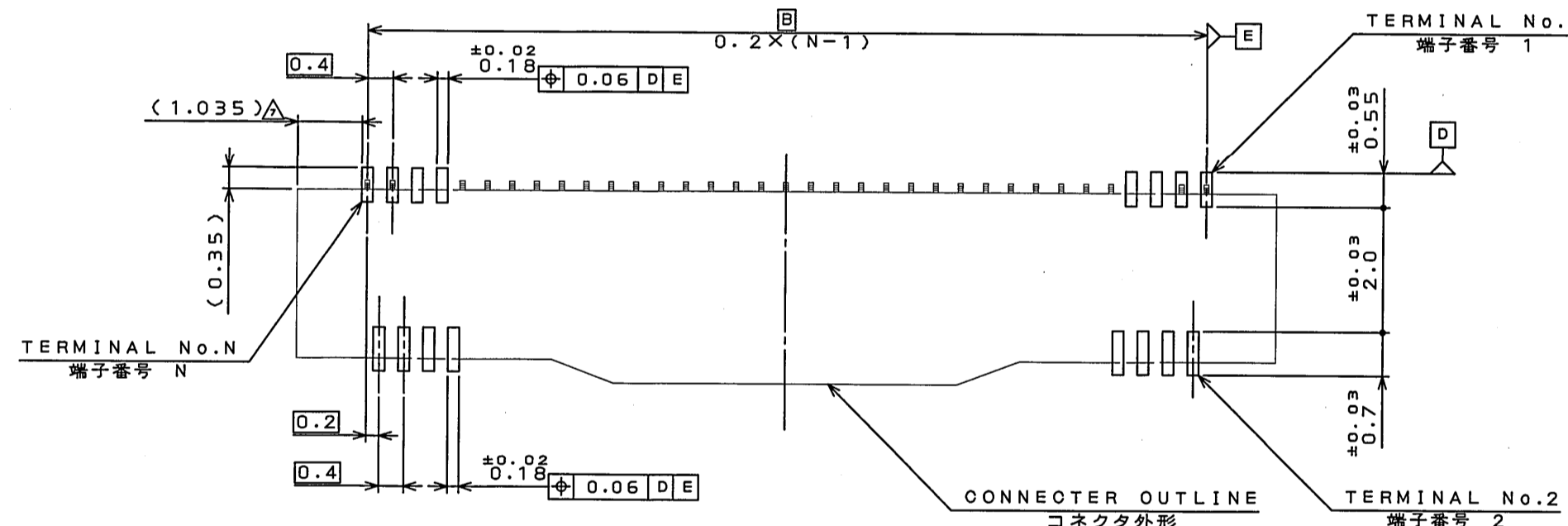
NO.	X
1	0.2
2	0.4
3	0.6
•	•
•	•
n	0.2 × (n-1)



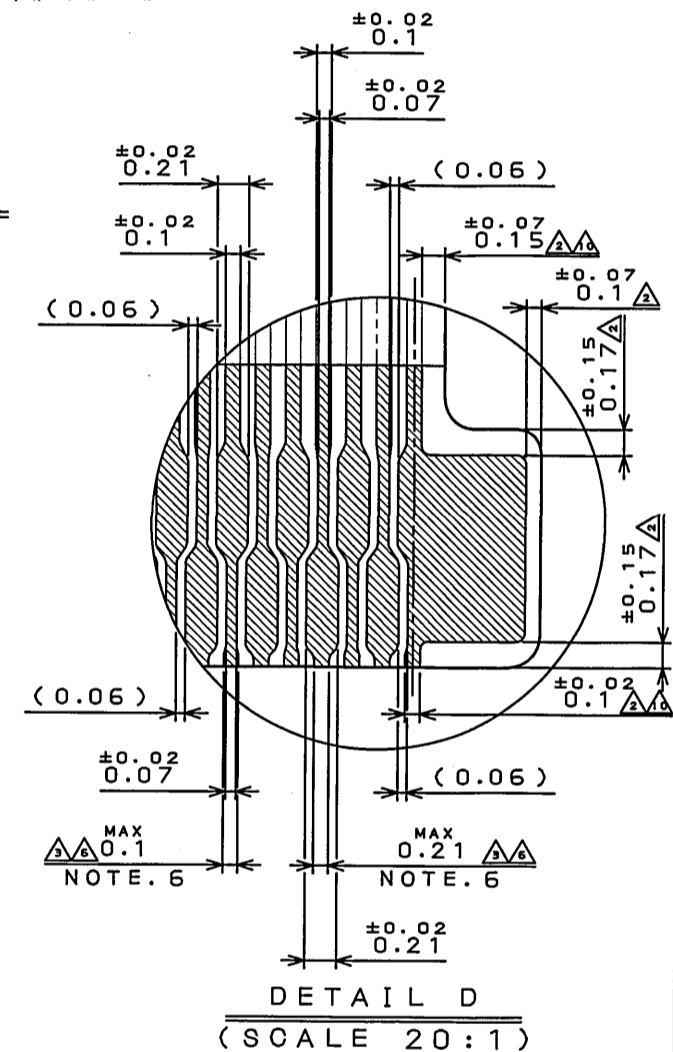
APPLICABLE F.P.C. DIMENSION (REF.)  
適合 FPC 寸法 (参考)



SECT. A-A  
(SCALE 20:1)



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)  
適合 基板寸法 (参考)



DETAIL D  
(SCALE 20:1)

TABLE 2. RECOMMENDED FPC COMPOSITION

COMPOSITION 層名	RECOMMENDED 推奨
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 圧延銅
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド

△ TABLE 1. DIMENSIONS

PRODUCT NO.	A	B	C	D
FF0825SA1	7.05	4.80	4.80	6.48
FF0829SA1	7.85	5.60	5.60	7.28
FF0841SA1	10.25	8.00	8.00	9.68
FF0851SA1	12.25	10.00	10.00	11.68
FF0871SA1	16.25	14.00	14.00	15.68
FF0881SA1	18.25	16.00	16.00	17.68

NOTE  
1. REFER TO TABLE 2 FOR RECOMMENDED FPC COMPOSITION.  
2. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP PORTION OF THE CONNECTOR.  
3. A NICKEL BARRIER EXISTS BETWEEN EACH CONTACT POINT AND TAIL.  
4. THE DIMENSIONS OF VACUUMING COVER AREA.  
5. OVERLAY EDGE INCLUDES A PROJECTION OF AN ADHESION LAYER.  
6. DIMENSION OF TIP IS OPTIONAL WITHIN ABOVE RANGE WITHOUT PATTERN PEELING.

注記  
1.推奨FPC構成はTABLE2参照のこと。  
2.ロット番号がコネクタ上面に表記される。  
3.各コンタクト接点とSMT部の間にはニッケルバリア有り。  
4.吸着エリアを示す。  
5.カバーレイ端面は接着層のみ出しを含む。  
6.先端部寸法は上記寸法範囲内で任意とし、パターン剥離を要。

4	ACTUATOR アクチュエータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱プラスチック	COLOR:BLACK/色相:黒色 UL94V-0
3	BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱プラスチック	COLOR:BEIGE/色相:肌色 UL94V-0
2	CONTACT 2 コンタクト 2	2	COPPER ALLOY 銅合金	PARTIAL GOLD(0.1μm MIN) OVER NICKEL ニッケル上部分Au 0.1μm以上
1	CONTACT 1 コンタクト 1	2	COPPER ALLOY 銅合金	PARTIAL GOLD(0.1μm MIN) OVER NICKEL ニッケル上部分Au 0.1μm以上
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書 (SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE) 16.Jul.2008	製図 DR.	10:1	FF08
公差 (GENERAL TOLERANCE)	△ JACS-10532- △ JAH-10532	製図 CHK.	K.ASHIBU	名称(TITLE) FF08**SA1
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	製図 APPD.	K.INOUE	(** : PIN COUNT)
• ±0.8	X° ±	承認 APPD.	Y.MIZUSAWA	質量(MASS)
• X ±0.4	X°X° ±			
• XX ±0.1				
• XXX ±				

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FF0881SA1](#)